

## 認定事業再編計画の実施状況の概要

1. 認定した年月日 平成27年12月24日
2. 認定事業者名 セイコーインスツル株式会社
3. 事業再編の実施期間 平成28年1月～平成30年3月

### 4. 事業再編に係る事業の達成状況等

#### (1) 事業再編に係る事業の達成状況

認定計画に基づき、以下のとおり事業再編を行った。

(事業の構造の変更)

##### ・出資の受入れ

エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社はセイコーインスツル株式会社及び株式会社日本政策投資銀行を引受先とする第三者割当増資を実施する。

増資額：18,480,000,000円（うち9,240,000,000円を資本金へ組入れ）

増資前の資本金額：10,000,000円

増資後の資本金額：9,250,000,000円

増資の方法：第三者割当増資

増資日：平成28年1月4日

発行する株式を引き受けた者：セイコーインスツル株式会社、  
株式会社日本政策投資銀行

##### ・半導体事業の会社分割（分社型吸収分割）

〈分割会社〉

名称：セイコーインスツル株式会社

住所：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目8番地

代表者の氏名：代表取締役 村上 斉

資本金：9,756,000,000円

〈承継会社〉

名称：エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社

住所：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目8番地

代表者の氏名：代表取締役 石合 信正

分割前の資本金額：9,250,000,000円

分割後の資本金額：9,250,000,000円

(前向きな取組)

車載用のECU（電子制御ユニット）向けに小型高精度・高耐圧・低消費電流のアナログ半導体の製造販売を行い、平成29年度には当該新商品の売上高をエイブリック株式会社（旧社名：エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社）の全売上高の1.8%以上とすることを目標としていたところ、実際には0.1%にとどまった。

#### (2) 生産性の向上を示す数値目標の達成状況

生産性の向上については、平成29年度は平成26年度と比べて従業員1人当たり付加価値額を8.77%向上させることを目標としていたところ、実際には0.84%悪化した。

有形固定資産回転率については、平成29年度は平成26年度と比べて27.66%の悪化にとどめることを目標としていたところ、実際には3.37%の悪化にとどまり、目標を達成した。

5. 事業再編に伴う労務に関する事項

(1) 事業再編の開始時期の従業員数（平成28年1月末実績）

セイコーインスツル株式会社	計画	1,781名	実績	1,752名
エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社	計画	772名	実績	742名

(2) 事業再編の終了時期の従業員数（平成30年3月末実績）

セイコーインスツル株式会社	計画	1,455名	実績	1,357名
エイブリック株式会社	計画	790名	実績	817名
（旧社名：エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社）				

(3) 事業再編に充てた従業員数（平成30年3月末実績）

セイコーインスツル株式会社	計画	0名	実績	0名
エイブリック株式会社	計画	790名	実績	817名
（旧社名：エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社）				

(4) (3)中、新規採用された従業員数（平成30年3月末までの実績）

セイコーインスツル株式会社	計画	0名	実績	0名
エイブリック株式会社	計画	30名	実績	46名
（旧社名：エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社）				

(5) 事業再編に伴い出向・転籍または解雇された従業員数（平成30年3月末までの実績）

出向・転籍予定人数	計画	772名	実績	773名
解雇予定人数	計画	0名	実績	0名

(注) エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社は、平成30年1月5日にエイブリック株式会社に商号変更しております。

以上